

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Znak sprawy: ZO.RPOWŁ/MS/1/2014

Łódź, dnia 15.03.2014 r.

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NA DOSTAWĘ OBWODU DRUKOWANEGO - SESTO TMSN rew1 (8 PCB)**

w ramach realizacji Projektu pt.

„Rozwój firmy Sesto Sp. z o. o. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego sterownika”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013

Priorytet III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

Numer Umowy: UDA-RPLD.03.03.00-00-005/12-00
rodzaj zamówienia: dostawa / ~~usługa~~ / ~~robota budowlana~~

Tryb udzielenia zamówienia: tryb przetargu

1. Nazwa, adres Zamawiającego:

Sesto Sp. z o. o.

ul. Wygodna 23
94-024 Łódź
www.sesto.pl

e-mail: biuro@sesto.pl
tel.: +48 42 688 03 05
fax: +48 42 688 04 70

NIP 525-243-21-67
REGON 141492005

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę obwodu drukowanego typu SESTO_TMSN_rew1 w il. 1 formatka (8 PCB), zamawianego w ramach realizacji Projektu pt. „Rozwój firmy Sesto Sp. z o. o. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego sterownika” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Priorytet III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach, (numer Umowy: UDA-RPLD.03.03.00-00-005/12-00).

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 1 formatki obwodu drukowanego SESTO_TMSN_rew1** składającej się z 8 płytek PCB. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do postępowania.**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 8 tygodni od daty złożenia zamówienia



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

3. Forma złożenia oferty

Oferty, prosimy przekazać w jeden w wymienionych poniżej sposobów:

- osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera – na adres Zamawiającego (dane w stopce)
- emaila na adres: marketing@sesto.pl

4. Termin składania ofert upływa w dniu: 21 marca 2014 r. godz. 16.00. Oferty przekazane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena – 100 pkt

Sposób przyznawania punktów:

max ilość punktów	kryterium	sposób przyznawania punktów
100	cena	<p style="text-align: center;">$P = (C_n / C_b) * 100$</p> <p>gdzie: P – liczba punktów za dane kryterium C_n – wartość netto w ofercie najtańszej C_b – wartość netto w ofercie badanej</p> <p><i>Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z realizacją zamówienia (z uwzględnieniem np. ewentualnych rabatów); cenę należy podać w walucie PLN lub EUR. Przeliczenie kursu nastąpi wg średniego kursu walut w NBP na dzień wyboru ofert.</i></p>

6. Wybór oferty nastąpi w dniu: 21 marca 2014 r. Zamawiający złoży Zamówienie Wykonawcy, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

7. Zmiana treści: Zamawiający ma prawo do zmiany treści ogłoszenia w terminie do 3 dni przed zakończeniem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje pisemnie (mailowo) wszystkich Wykonawców, którzy do daty zmiany treści ogłoszenia przesłali swoje oferty a także opublikuje zmianę treści na swojej stronie internetowej.

9. Pytania: Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zapytania określonych w niniejszym zaproszeniu. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Piotr Sakowski tel.: 796 737 866 lub Magdalena Sakowska tel.: (42) 688 03 05.

10. Miejsce dostawy: Dostawca dostarczy gotowy materiał zgodny z opisem przedmiotu (załącznik 1) na adres Zamawiającego: ul. Wygodna 23, 94-024 Łódź.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

11. Warunki płatności: Zamawiający dokona zapłaty za dostarczone urządzenie/oprogramowanie przelewem na konto podane na fakturze. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru.

12. Załącznikami do niniejszego Zapytania są:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – *Załącznik Nr 1*

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Piotr Sakowski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Znak sprawy: ZO.RPOWŁ/MS/1/2014

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 formatki OBWODU DRUKOWANEGO –
SESTO_TMSN_rew1 (8 PCB)**

Pliki warstw: w formacie Gerber, rozdzielczość 2:5

Rozkład warstw:

- Top Overlay
- Top Solder Mask (negatyw)
- Top Layer
- Prepreg
- Internal Plane 1 (negatyw)
- Core
- Internal Plane2 (negatyw)
- Prepreg
- Mid Layer 1
- Core
- Mid Layer 2
- Prepreg
- Internal Plane3 (negatyw)
- Core
- Internal Plane4 (negatyw)
- Prepreg
- Bottom Layer
- Bottom Solder Mask (negatyw)
- Bottom Overlay
- Mechanical Layer 1 (obrys pojedynczej płytki)
- Mechanical Layer 2 (obrys panelu)
- Mechanical Layer 4 (wymiary pojedynczej płytki)
- Mechanical Layer 5 (linia rylcowania)
- Mechanical Layer 6 (wymiary panelu)

Uwagi:

1. Formatka 8 płytek 8-warstwowych (162.6mm x 58.7mm) z metalizacją otworów.
2. Wymiar formatki 339.2mm x 248.8mm.
3. Warstwa przeciwlutowa (soldermaska) z obu stron.
4. Opisy na warstwie Top Overlay i Bottom Overlay.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

5. Średnice otworów po metalizacji – podane.
6. W niektórych miejscach opisy mogą nakładać się na pady i przelotki. W tych miejscach należy usunąć farbę z miejsc odmaskowanych.
7. Laminat wysokotemperaturowy FR-4 (Tg170), 1.6mm, podstawowa grubość miedzi 18u, (finalna min. 30um na warstwach zewnętrznych).
8. Laminat powinien być dostosowany do dwustronnego, rozplwowego lutowania bezołowiowego elementów SMD (wysokotemperaturowy).
9. Pokrycie: złocenie (immersion Ni/Au).
10. Test elektryczny.
11. Płytką drukowaną umieszczoną jedynie w lewym, dolnym rogu formatki. Należy powielić ją w pozostałych miejscach.
12. Ilość sztuk na formatce: 2 x 4 szt.
13. Frezowanie - płytką nie jest prostokątem, otwór w środku.
14. Nie wykonywać szablonu do nakładania pasty lutowniczej.

